

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-164586
(43)Date of publication of application : 16.06.2000

(51)Int.Cl. H01L 21/308
C09K 13/08
C23F 1/16

(21)Application number : 10-332782 (71)Applicant : DAIKIN IND LTD
(22)Date of filing : 24.11.1998 (72)Inventor : KEZUKA TAKEHIKO
SUYAMA MAKOTO
ITANO MITSUSHI

(54) ETCHANT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an etchant which is capable of selectively etching a doped oxide film by a method wherein the etchant which contains hydrogen fluoride and has etching properties where ratio of an etching rate of boron silicate glass film or boron phosphorus silicate glass against etching rate of thermal oxide film is equal to a specific value or above is used.

SOLUTION: An etching rate boron silicate glass film (BSG)/thermal oxide film (THOX) and/or an etching rate boron phosphorus silicate glass film (BPSG)/THOX are set equal to 10 or above at a temperature of 25° C. The etchant has a dielectric constant of about 61 or below and contains at least an element selected out of a group composed of organic acid and organic solvent with hetero atoms. The etchant is about 0.01 to 50 wt.% in hydrogen fluoride, about 70 wt.% or below in water content, about 1 to 99 wt.% in inorganic acid content, about 30 to 99.9 in organic acid content, and about 30 to 99.9 wt.% in content of organic solvent with hetero atoms. By this setup, doped oxide film is selectively etched.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 31.05.2001
[Date of sending the examiner's decision of rejection] 17.11.2004
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection] 2004-025659
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] 16.12.2004
[Date of extinction of right]

**Partial Translation of Japanese Unexamined Patent
Publication No.2000-164586**

[0012] Examples of organic solvents containing heteroatoms include methanol, ethanol, isopropanol (IPA), 1-propanol, 1-butanol, 2-butanol, t-butanol, 2-methyl-1-propanol, 1-pentanol, 1-hexanol, 1-heptanol, 4-heptanol, 1-octanol, 1-nonylalcohol, 1-decanol, 1-dodecanol and like alcohols; ethylene glycol, 1,2-propanediol, propylene glycol, 2,3-butanediol, glycerol and like polyols, acetone, acetylacetone, methyl ethyl ketone and like ketones; acetonitrile, propionitrile, butyronitrile, isobutyronitrile, benzonitrile and like nitriles; formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde and like aldehydes; ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether and like alkylene glycol monoalkyl ethers; tetrahydrofuran, dioxane and like ethers, trifluoroethanol, pentafluoropropanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol and like fluorinated alcohols, sulfolane, nitromethane; etc.

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-164586

(P 2 0 0 0 - 1 6 4 5 8 6 A)

(43) 公開日 平成12年6月16日 (2000. 6. 16)

(51) Int. Cl. 7

H01L 21/308

C09K 13/08

C23F 1/16

識別記号

F I

H01L 21/308

C09K 13/08

C23F 1/16

テマコード (参考)

E 4K057

5F043

審査請求 未請求 請求項の数16 O L (全10頁)

(21) 出願番号

特願平10-332782

(22) 出願日

平成10年11月24日 (1998. 11. 24)

(71) 出願人 000002853

ダイキン工業株式会社

大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号

梅田センタービル

(72) 発明者 毛塚 健彦

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン
工業株式会社淀川製作所内

(72) 発明者 陶山 誠

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン
工業株式会社淀川製作所内

(74) 代理人 100065215

弁理士 三枝 英二 (外10名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】エッチング液

(57) 【要約】

【課題】不純物をドープした酸化膜を選択的にエッチングする。

【解決手段】フッ化水素 (HF) を含み、ボロンガラス膜 (B-S-G) もしくはボロンリンガラス膜 (B-P-S-G) のエッチングレート／熱酸化膜 (T-H-O-X) のエッチングレートが25°Cで10以上であるエッチング液。

【特許請求の範囲】

【請求項1】フッ化水素(HF)を含み、ボロンガラス膜(BSG)もしくはボロンリンガラス膜(BPSG)のエッティングレート/熱酸化膜(THOX)のエッティングレートが25℃で10以上であるエッティング液。

【請求項2】エッティング液の溶媒の比誘電率が6.1以下である請求項1記載のエッティング液。

【請求項3】有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1に記載のエッティング液。

【請求項4】水及び有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含み、水の濃度が70重量%以下である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項5】HF:イソプロピルアルコール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項6】HF:酢酸:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項7】HF:テトラヒドロフラン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項8】HF:アセトン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項9】HF:メタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項10】HF:エタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

【請求項11】無機酸を含む請求項1に記載のエッティング液。

【請求項12】無機酸の25℃でのpKa値が2以下である請求項11に記載のエッティング液。

【請求項13】HF:HC1:水の重量比が0.01~50重量%:1~36重量%:0~99重量%である請求項12に記載のエッティング液。

【請求項14】HF:HNO₃:水の重量比が0.01~50重量%:1~70重量%:0~99重量%である請求項12に記載のエッティング液。

【請求項15】請求項1~14のいずれかに記載のエッティング液を用いて被エッティング物をエッティング処理するエッティング処理物の製造方法。

【請求項16】請求項15の方法により得ることができるエッティング処理物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、エッティング液、エ

ッティング処理物の製造方法及び該方法により得ができるエッティング処理物に関し、より詳しくは、ドープ酸化膜、特にBSG又はBPSGを非ドープ酸化膜、特にTHOXに対して選択的にエッティングするエッティング液、エッティング処理物の製造方法及び該方法により得ができるエッティング処理物に関する。

【0002】

【従来の技術及びその課題】従来、シリコンウェハなどのエッティング剤は、HF(50重量%)とNH₄F(40重量%)を所望のエッティングレートになるように適当な割合で混合したバッファードフッ酸が用いられていました。

【0003】しかしながら、バッファードフッ酸は、BSG、BPSG、リンガラス膜(PSG)、砒素ガラス膜(AsSG)などのドープ酸化膜及びTEOS(テトラエトキシシランガスを用いたCVD法による酸化膜)等のUSG、THOXなどの非ドープ酸化膜とともにエッティングするため、ドープ酸化膜を選択的にエッティングすることはできなかった。

【0004】本発明は、TEOS、THOXに対し不純物をドープした酸化膜を選択的にエッティングするエッティング液及びエッティング方法を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明は、以下の項1~項16に関する。

項1. フッ化水素(HF)を含み、ボロンガラス膜(BSG)もしくはボロンリンガラス膜(BPSG)のエッティングレート/熱酸化膜(THOX)のエッティングレートが25℃で10以上であるエッティング液。

項2. エッティング液の溶媒の比誘電率が6.1以下である請求項1記載のエッティング液。

項3. 有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1に記載のエッティング液。

項4. 水及び有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含み、水の濃度が70重量%以下である請求項1に記載のエッティング液。

項5. HF:イソプロピルアルコール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

項6. HF:酢酸:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

項7. HF:テトラヒドロフラン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

項8. HF:アセトン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッティング液。

項9. HF : メタノール : 水の重量比が0. 1~50重量% : 30~99. 9重量% : 0~70重量%である項1に記載のエッティング液。

項10. HF : エタノール : 水の重量比が0. 1~50重量% : 30~99. 9重量% : 0~70重量%である項1に記載のエッティング液。

項11. 無機酸を含む項1に記載のエッティング液。

項12. 無機酸の25℃でのpKa値が2以下である項1に記載のエッティング液。

項13. HF : HCl : 水の重量比が0. 01~50重量% : 1~36重量% : 0~99重量%である項12に記載のエッティング液。

項14. HF : HNO₃ : 水の重量比が0. 01~50重量% : 1~70重量% : 0~99重量%である項12に記載のエッティング液。

項15. 項1~14のいずれかに記載のエッティング液を用いて被エッティング物をエッティング処理するエッティング処理物の製造方法。

項16. 項15の方法により得ることができるエッティング処理物。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明のエッティング液は、BSG/THOXのエッティングレートもしくはBPSG/THOXのエッティングレートのいずれか一方あるいは両方が、25℃で10以上、好ましくは20以上、より好ましくは50以上、特に100以上である。

【0007】なお、THOXに代えてTEOSとの比は、BSG/TEOSのエッティングレートもしくはBPSG/TEOSのエッティングレートのいずれか一方あるいは両方が、25℃で5以上、好ましくは10以上、より好ましくは50以上、特に100以上である。

【0008】本発明のエッティング液のエッティングレートは、本発明のエッティング液を用いて各膜(BSG; BPSG; THOX; TEOS等のUSGなど)をエッティングし、エッティング前後での膜厚の差をエッティング時間で割って、計算により求めることができる。

【0009】本明細書におけるエッティング液の比誘電率は、61以下、好ましくは50以下、より好ましくは30以下である。エッティング液の比誘電率は、HF及び無機酸以外のエッティング液の各成分の比誘電率を相加平均で表した値である。

【0010】無機酸としては、好ましくは25℃でのpKa値が2以下の無機酸が挙げられ、例えば塩酸(pKa=-8)、硝酸(pKa=-1.8)、臭化水素酸(pKa=-9)、ヨウ化水素酸(pKa=-10)、過塩素酸(pKaが測定できないほどの強酸)が例示される。

【0011】有機酸としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、カプロン酸、カブリル酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、モノフル

オロ酢酸、ジフルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、 α -クロロ酢酸、 β -クロロ酢酸、 γ -クロロ酢酸、乳酸、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、アクリル酸等のモノカルボン酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸等のスルホン酸、シウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸、クエン酸等のポリカルボン酸が挙げられる。

【0012】ヘテロ原子を有する有機溶媒としては、メタノール、エタノール、イソプロパノール(IPA)、

1-ブロパノール、1-ブタノール、2-ブタノール、t-ブタノール、2-メチル-1-ブロパノール、1-ペンタノール、1-ヘキサノール、1-ヘプタノール、4-ヘプタノール、1-オクタノール、1-ノニルアルコール、1-デカノール、1-ドデカノールなどのアルコール類；エチレングリコール。1, 2-ブロパンジオール、プロピレングリコール、2, 3-ブタジオール、グリセリンなどのポリオール類、アセトン、アセチルアセトン、メチルエチルケトン等のケトン類；アセトニトリル、プロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリル、ベンゾニトリル等のニトリル類；ホルムアルデヒド、アセタルデヒド、プロピオンアルデヒドなどのアルデヒド類；エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテル；テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類、トリフルオロエタノール、ペニタフルオロプロパノール、2, 2, 3, 3-テトラフルオロプロパノール等のフッ素アルコール、スルホラン、ニトロメタン等が挙げられる。

【0013】HFの含有量は、0. 01~50重量%程度、好ましくは1~5重量%程度である。

【0014】水の含有量は、70重量%以下、好ましくは30重量%以下、より好ましくは0~5重量%程度である。

【0015】無機酸の含有量は、1~99重量%程度、好ましくは30~70重量%程度である。

【0016】有機酸の含有量は、30~99. 9重量%程度、好ましくは70~99. 9重量%程度である。

【0017】ヘテロ原子を有する有機溶媒の含有量は、30~99. 9重量%程度、好ましくは70~99. 9重量%程度である。

【0018】無機酸、有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種の含有量は、30~99. 9重量%程度、好ましくは70~99. 9重量%程度である。

【0019】無機酸の25℃におけるpKaは、約2以下、好ましくは約-5以下程度である。

【0020】有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒の誘電率は、好ましくは約40以下、より好ましくは約10以下である。

【0021】HFとしては、希フッ酸(50重量%水溶

液)を通常用いるが、水を含まない場合には、100% HFを用いることもできる。同様にHCl、HBr、HIの場合には、これらのガスをエッティング液に吹き込むことにより無水のエッティング液を得ることができる。

【0022】本発明の好ましいエッティング液及びその配合比を以下に示す。

- ・HF:IPA:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF:酢酸:水=0.5~5重量%:70~99.5重量%:0~30重量%
- ・HF:HCl:水=0.01~5重量%:1~36重量%:50~99重量%
- ・HF:硝酸:水=0.01~5重量%:1~70重量%:20~99重量%
- ・HF:アセト:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF:THF:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF:メタノール:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF:エタノール:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%

本発明のエッティング液は、B、Pなどをドープした酸化膜(BSG、BPSG等)及びTHOXやTEOS等の非ドープ酸化膜を有する被エッティング物でドープ酸化膜を選択的にエッティングするのに好適に使用できる。

【0023】本発明のエッティング方法において、エッティング液の温度は15~40°C程度である。

【0024】被エッティング物としては、シリコン単結晶ウェハ、ガリウム-砒素ウェハなどのウェハが挙げられ、特にドープ酸化膜(BSG、BPSGなど)と非ドープ酸化膜(THOX、TEOS等のUSG)を有する被エッティング物が好ましい。

【0025】本発明のエッティング液のエッティングレートはBSGに対して通常10~2000nm/min程度、好ましくは40~500nm/min程度である。

【0026】

【発明の効果】本発明によれば、THOX、TEOS等

のUSGに対しBSG、BPSGなどの不純物をドープした膜を選択的にエッティングできるエッティング液、該エッティング液を用いたエッティング処理物の製造方法及びエッティング処理物を提供できる。

【0027】

【実施例】以下、本発明を実施例および比較例を用いてより詳細に説明する。

実施例1~2及び比較例1~4(無機酸)

HF、水及びヘテロ原子を含む有機溶媒(イソプロピルアルコール(IPA)、THF、アセトン、メタノール、エタノール)、有機酸(酢酸)、無機酸(HCl、HNO₃)を表1で表される割合で含んだエッティング液を調合し、シリコン基板上に熱酸化膜(THOX)、テトラエトキシシランガスを用いたCVD法によるUSG(TEOS)、ボロンガラス膜(BSG)、ボロンリングガラス膜(BPSG)を形成した試験基板に対するエッティングレート及び選択比を求めた。

【0028】さらに、比較例として従来のHF-H₂Oのエッティング液及びHF-NH₄F-H₂Oのエッティング液を用い、同様にエッティングレート及び選択比を求めた。

【0029】エッティングレートは、Rudolf Research社Auto EL-IIIエリプリメータを用いてエッティング前後の膜厚を測定することで行った。

【0030】エッティング液のエッティングレートは、各エッティング液を25°Cで各膜をエッティングし、エッティング前後での膜厚の差をエッティング時間で割って計算したものである。

【0031】各組成での結果を、表1~表8に示す。

【0032】なお、比誘電率は、溶媒(ヘテロ原子を含む有機溶媒または有機酸)+水の誘電率として25°Cにおける溶媒の比誘電率と水の比誘電率の、その組成での平均値を計算値として示す。

比誘電率の平均値= [(78.3×(水の重量%)+(溶媒の25°Cでの比誘電率)×(溶媒の重量%)) / [(水の重量%)+(溶媒の重量%)]]

【0033】

【表1】

HF-H₂O-インプロピルアルコール(IPA)のエッチング

被説明	被説明	HF濃度	HF濃度	水濃度	被説明(IP)	被説明(IP)	+水の比	電圧	TEOS	エッチングレ	ESG	BPSG	BPSG/T	BPSG/TH	ESG/T	ESG/TH	BPSG/TE	BPSG/OS	ESG/TE	ESG/OS
実験1	IPA	19.9	5	5	90	23.0	12	11	370	330	31	28	34	30						
実験2	IPA	19.9	5	25	70	35.3	55	76	920	1160	17	21	12	15						
実験3	IPA	19.9	5	45	50	47.6	97	140	1190	1650	12	17	8.5	12						
実験4	IPA	19.9	5	65	30	58.9	140	200	1450	1950	10	14	7.3	9.8						
実験5	IPA	19.9	3	3	94	21.7	2	3	120	-	60	-	40	-						
実験6	IPA	19.9	10	10	80	26.4	59	82	2200	-	37	-	27	-						
実験7	IPA	19.9	15	15	70	30.2	350	230	6500	-	28	-	19	-						
実験8	IPA	19.9	20	20	60	34.5	820	1200	12000	-	15	-	10	-						
BBM1	(A)	(78.3)	1	99	0	-	58	93	380	-	6.5	-	4.1	-						
BBM2	(A)	(78.3)	2	98	0	-	120	190	750	-	6.3	-	3.9	-						
BBM3	(A)	(78.3)	5	95	0	-	300	490	1980	-	6.6	-	4.0	-						

【表2】

【0034】

HF-H₂O-酢酸のエッチャント

【0035】
【表3】

	序番名	液量の比	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	酸濃度 (%)	酸濃度(%) +水の比率	酸濃度 (付算量)	THOK エチシングレ ート (A/分)	TEOS エチシングレ ート (A/分)	BSG エチシングレ ート (A/分)	BPSG エチシングレ ート (A/分)	BSG/T H ₂ O 液比	BSG/T EOS 液比	BPSG/T H ₂ O 液比	BPSG/T EOS 液比
実施例9	酢酸	6.15	1	1	98	6.88	10	14	530	750	53	75	38	54	—
実施例10	酢酸	6.15	1.25	1.25	97.5	7.08	12	18	1200	940	100	78	67	67	52
実施例11	酢酸	6.15	1.5	1.5	97	7.25	17	22	1600	1300	94	76	73	73	59
実施例12	酢酸	6.15	2	2	96	7.92	25	33	2600	—	100	—	79	—	—
実施例13	酢酸	6.15	2.5	2.5	95	8	32	45	3600	—	110	—	80	—	—
実施例14	酢酸	6.15	3	3	94	8.38	40	56	4600	—	120	—	84	—	—
実施例15	酢酸	6.15	5	5	90	9.95	97	140	8900	—	92	—	64	—	—
実施例16	酢酸	6.15	1.25	5	93.75	9.80	18	23	1600	—	89	—	70	—	—
実施例17	酢酸	6.15	1.25	10	88.75	13.5	20	32	1300	—	65	—	41	—	—
実施例18	酢酸	6.15	1.25	20	78.75	20.8	32	46	970	—	30	—	21	—	—
実施例19	酢酸	6.15	1.25	30	68.75	28.1	39	58	830	—	21	—	14	—	—
実施例20	酢酸	6.15	1.25	40	58.75	35.4	40	65	670	—	17	—	10	—	—
実施例21	酢酸	6.15	1.25	50	48.75	42.7	43	72	590	—	14	—	8.2	—	—

HF-H₂O-アセトン(THF)のエッチャント

	液組成	HFの比 割合	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶解(T) HF)液 成 (%)	溶解(THF) +水の比 割合 (%)	THOX 電解 (付加物)	TEOS エッチャング レ (A/分)	ESG エッチャング レ (A/分)	BPSG エッチャング レ (A/分)	BSG/T HOX 気比 通気比	BSG/T/H HOX 気比 通気比	BPSG/TE OS 通気比
実験例22	THF	7.6	5	5	90	11.3	3	4	510	330	170	110	130
実験例23	THF	7.6	5	25	70	26.2	31	42	690	830	22	27	16
実験例24	THF	7.6	6	45	60	41.1	64	85	890	1200	14	19	10
実験例25	THF	7.6	5	65	30	56.0	110	150	1200	1600	11	16	8
													11

【0036】
【表4】HF-H₂O-アセトン(エチレン)

	液組成	HFの 比割合 率	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	溶解(A セト)液 成 (%)	溶解(Aセト +水の 比割合 (%)	THOX 電解 (付加物)	TEOS エッチャング レ (A/分)	ESG エッチャング レ (A/分)	BPSG エッチャング レ (A/分)	BSG/T HOX 気比 通気比	BSG/T/H HOX 気比 通気比	BPSG/TE OS 通気比
実験例26	アセトン	20.7	5	5	90	23.7	3	4	410	250	140	83	100
実験例27	アセトン	20.7	5	25	70	35.9	24	29	440	520	18	22	15
実験例28	アセトン	20.7	5	45	50	48.0	49	67	620	760	13	16	9.3
実験例29	アセトン	20.7	5	65	30	60.1	96	140	960	1500	10	14	6.9
													9.3

【0037】
【表5】

HF-H₂O-メタノールのエッチャント

	被験名	被験の比	HF濃度	水濃度	被験(タ)ー 水の比	THOX	TEOS	BPSG	BPSG/T	BSG/T	BPSG/TE
	新規	既存	(%)	(%)	(%)	エッチャングレ ー	エッチャングレ ー	エッチャングレ ー	HOX濃 度	OX 濃度	CS 濃度
実験30	メタノール	32.0	3	3	94 (計算値)	34.0 (A/分)	0.5 (A/分)	7 (A/分)	44 (A/分)	73 (A/分)	88 (A/分)
実験31	メタノール	32.0	5	5	90 (計算値)	35.0 (A/分)	3 (A/分)	9 (A/分)	170 (A/分)	230 (A/分)	57 (A/分)
実験32	メタノール	32.0	10	10	80 (計算値)	39.9 (A/分)	22 (A/分)	43 (A/分)	730 (A/分)	410 (A/分)	33 (A/分)

【0038】
【表6】

HF-H₂O-エタノールのエッチャント

	被験名	被験の比	HF濃度	水濃度	被験(タ)ー 水の比	THOX	TEOS	BPSG	BPSG/T	BSG/T	BPSG/TE
	新規	既存	(%)	(%)	(%)	エッチャングレ ー	エッチャングレ ー	エッチャングレ ー	HOX濃 度	OX 濃度	CS 濃度
実験33	エタノール	24.0	5	5	90 (計算値)	27.4 (A/分)	7 (A/分)	9 (A/分)	250 (A/分)	210 (A/分)	36 (A/分)

【0039】
【表7】

HF-NH₄HF-H₂Oのエッチャント(比較例)

	溶液名	溶液の比	HF濃度	NH ₄ HF (水)量 (%)	被膜 (水)量 (%)	TEOS エチシング 皮 (A/分)	TEOS エチシング 皮 (A/分)	BPSG エチシング 皮 (A/分)	BPSG/T HDX 比	BPSG/TH OX 比	BSG/T HDX 比	BSG/TE OS 比
比較例4	(水)	(78.3)	1	39.1	59.9	170	230	110	-	0.6	-	0.5
比較例5	(水)	(78.3)	2	2	96	280	480	620	-	2.2	-	1.3
比較例6	(水)	(78.3)	2	5	93	320	640	440	-	1.4	-	0.7
比較例7	(水)	(78.3)	2	10	88	400	700	360	-	0.9	-	0.6
比較例8	(水)	(78.3)	2	20	78	420	720	270	-	0.6	-	0.4
比較例9	(水)	(78.3)	2	30	68	390	610	230	-	0.6	-	0.4
比較例10	(水)	(78.3)	2	38.7	59.3	300	450	200	-	0.7	-	0.4

【0040】
【表8】

HF-H₂O-酸添加のエッチャント

実験番号	名	酸の pH	HF濃度 (%)	水濃度 (%)	濃度 (%)	TEOS (A/分)	BSG (A/分)	BPSG (A/分)	BSG/T 比	BPSG/TH 比	BSG/T 比	BPSG/TH 比	BSG/T 比	EOS 濃度 (%)	EOS 濃度 (%)	EOS 濃度 濃度比	
実験番号34	HCl	-8	0.1	64	35.9	17	32	440	-	2.5	-	1.4	-	-	-	-	
実験番号35	HCl	-8	0.25	63.9	35.8	53	69	1200	-	23	-	13	-	-	-	-	
実験番号36	HCl	-8	0.5	63.9	35.6	120	200	2500	-	21	-	13	-	-	-	-	
実験番号37	HCl	-8	0.75	63.8	35.5	180	300	4300	-	24	-	14	-	-	-	-	
実験番号38	HCl	-8	1	63.7	35.3	240	380	4500	-	19	-	12	-	-	-	-	
実験番号39	HNO ₃	-1.8	1	30.4	68.6	240	340	5300	-	22	-	16	-	-	-	-	
実験番号41	HPO ₄	2.15	1	16.7	83.3	120	170	850	-	8.7	-	5.3	-	-	-	-	

フロントページの続き

(72)発明者 板野 充司

大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン

工業株式会社淀川製作所内

F ターム(参考) 4K057 WA13 WB06 WB11 WE01 WE02

WE07 WE11

5F043 AA31 AA37 BB22 DD30 CG10